

## 第 2 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 25 年 7 月 17 日(水) 10:30～15:55

場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時 間	題 目	講 演 者	
平成 25 年 7 月 17 日  水 曜 日	10:30～ 10:35	委 員 長 挨拶	
	10:35～ 12:05	司 会 岩田 剛治(大阪大学)	
		『はんだ接合部における エレクトロマイグレーション現象』 (40 分)	大阪大学 ○上西 啓介 (株)富士通研究所 赤松 俊也、作山 誠樹
		『三次元ヘテロ集積化技術とスーパーチップ』 (50 分)	東北大学 ○小柳 光正
	12:05～ 13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～ 13:05	委 員 会 議 事	
	13:05～ 15:55	司 会 松嶋 道也(大阪大学)	
		『半導体チップの3次元積層における 設計フローと課題』 (40分)	ケイレックス・テクノロジー(株) ○川瀬 英路
		『シングル・チップ・モジュール/ マルチ・チップ・モジュールから3D-ICへの IBMパッケージ技術の展開』 (40分)	日本 IBM(株) ○久田 隆史
		休 憩(10 分)	
『SMT実装工程の良品生産システムの提案』 (40 分)		パナソニック ファクトリーソリューションズ(株) ○井上 雅文	
	『メタルマスク不要 クリームハンダジェット プリンターについて』 (40 分)	マイクロニック・マイデータ・ジャパン(株) ○辻村 武彦	

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。